2007788-2 AKTIV

IMPACT

Interne TE-Nummer 2007788-2

IMPACT, High Speed Backplane Connectors, Board-to-Board, 90

Position, Row-to-Row Spacing 1.35 mm [.053 in], Mating Alignment,

Polarization, 9 Rows

Auf TE.com ansehen>

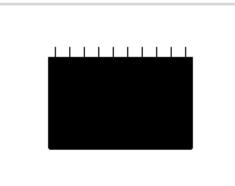


Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckverbinder > Backplane-Steckverbinder >

Hochgeschwindigkeits-Steckverbinder











Steckverbindersystem: Leiterplatte-an-Leiterplatte

Anzahl von Positionen: 90

Row-to-Row Spacing: 1.35 mm [.053 in]

Gegensteckführung: Mit

Typ der Gegensteckführung: Polarisierung

Eigenschaften

Produktmerkmale

Signalanordnung	Differenzial
Steckverbindersystem	Leiterplatte-an-Leiterplatte
PCB-Steckverbindermontagetyp	Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
Hülsen-Ausführung	Teilweise ummantelt
Abdichtbar	Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte
Konfigurationsmerkmale	
Anzahl der Massepositionen	30
Anzahl der Paare	30
Stapelbar	Nein
Anzahl der Signalpositionen	60
Anzahl von Positionen	90
Zeilenanzahl	9



Spaltenanzahl	10
Montageausrichtung für Leiterplatte	Vertikal
Führungsposition	Nicht geführt
Elektrische Kennwerte	
Impedanz	100 Ω
Operating Voltage	30 VAC
Signalmerkmale	
Anzahl der Differenzialpaare pro Spalte	3
Datenrate	20 – 25 Gb/s
Kontaktmerkmale	
Kontaktaufbau	Verbindungsmuffe
Länge des Steckbereichs des Kontakts	4.9 mm[.193 in]
Dicke des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	.76 – 1.52 μm[30 – 60 μin]
Kontakttyp	Stift
Dicke des Unterbeschichtungsmaterials des Kontakts	1.27 μm[50 μin]
Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts	.76 μm[29.92 μin]
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Gold
Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Matt
Kontaktform	Doppelstrahl, Doppelstrahl
Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts	Nickel
Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Zinn
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Kontaktnennstrom (max.)	.75 A
Klemmenmerkmale	
Anschlussstift- und Restlänge	1.4 mm[.055 in]
Verbindungsmethode für Leiterplatte	Durchsteckmontage – Press-Fit
Montage und Anschlusstechnik	
Gegensteckarretierung	Ohne
Führungskomponenten	Ohne
Arretierung für Leiterplattenmontage	Mit



Art der Leiterplattenmontage	Aktions-/Kompatibles Endstück
Gegensteckführung	Mit
Typ der Gegensteckführung	Polarisierung
Art der Steckverbindermontage	Leiterplattenmontage
Gehäusemerkmale	
Anzahl der gehüllten Seiten	Zweiseitig
Endwandposition	Öffnen
Gehäusematerial	LCP – GF (Flüssigkristallpolymer), LCP – GF (Flüssigkristallpolymer)
Gehäusefarbe	Schwarz
Raster	1.9 mm[.075 in]
Abmessungen	
Steckverbinderlänge	18.9 mm[.744 in]
Steckverbinderhöhe	11.95 mm[.47 in]
Steckverbinderbreite	16.7 mm[.657 in]
Leiterplattendicke (empfohlen)	1 mm
PCB Hole Diameter	.36 mm[.014 in]
Row-to-Row Spacing	1.35 mm[.053 in]
Verwendungsbedingungen	
Betriebstemperaturbereich	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
Betrieb/Anwendung	
Stromkreis Anwendung	Signal
Industriestandards	
UL-Dateinummer	E28476
UL-Grad	Anerkannt
CSA zertifiziert	Ja
UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0
Verpackungsmerkmale	
Verpackungsmethode	Karton & Schlauch, Karton & Schlauch, Package

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>



EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020 (205) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUN 2012 (84) Enthält keine SVHC
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020 (205) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUN 2012 (84)
Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Bezüglich der REACH Bestimmungen beruht die TE-Information über SVHC in den Artikeln für diese Teilenummer noch auf den "Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen" (Version: 2, April 2011) der European Chemicals Agency (ECHA), wobei der Grenzwert von 0,1% (nach Gewicht) auf das Fertigprodukt bezogen ist. TE ist sich des EuGH-Urteils vom 10. September 2015, auch bekannt als O5A (Once An Article Always An Article), bewusst, welches besagt, dass im Falle von 'komplexen Erzeugnissen', der Schwellenwert für eine SVHC sowohl auf das Produkt als Ganzes und gleichzeitig auf jeden der Artikel, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, angewendet wird. TE hat diesen Entscheid auf der Grundlage der neuen ECHA 'Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen' (Juni 2017, Version 4,0) ausgewertet und wird seine Deklarationen entsprechend aktualisieren.

Kompatible Teile



TE Teilenummer 2007705-1 IMP100S,R,RA3P10C,UG,39



TE Teilenummer 2007704-1 IMP100S,R,RA3P10C,RG,39



TE Teilenummer 2007703-1 IMP100S,R,RA3P10C,LG,39



TE Teilenummer 2007702-1 IMP100S,R,RA3P10C,UG,46





TE Teilenummer 2007701-1 IMP100S,R,RA3P10C,RG,46



TE Teilenummer 2007700-1 IMP100S,R,RA3P10C,LG,46

Auch serienmäßig | IMPACT



Hochgeschwindigkeits-Backplane-Steckverbinder (1773)

Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilenummer4-2176057-2 RLP73K 3A R51 1% 1K RL



TE Teilenummer2007705-1 IMP100S,R,RA3P10C,UG,39



TE Teilenummer2007626-2 1x4 QSFP Kit Assy Sqr LP, Networking



TE Teilenummer4-2176307-6 RP 1E 0.1W 36K5 0.1% 25PPM 5K RL



TE Teilenummer2057426-3 IMP100S,H,V2P10C,UG,OEW46,5.5



TE Teilenummer2057736-2 IMP100S,H,V2P16C,LG,OEW46,4.9



TE Teilenummer3-1879131-5 RN 0402 7K68 0.1% 10PPM 1K RL



TE Teilenummer2057042-5 1x3 QSFP Kit Assy Lp&HS, SAN



TE Teilenummer2057042-8

1x3 QSFP Kit Assy LP&HS, Networking





Dokumente

Produktzeichnungen

IMP100S,H,V3P10C,UG,OEW39,4.9

Englisch

CAD-Dateien

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_2007788-2_B.3d_stp.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_2007788-2_B.2d_dxf.zip

Englisch

3D PDF

3D

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_2007788-2_B.3d_igs.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den **allgemeinen Verkaufsbedingungen** zu.

Produktspezifikationen

Anwendungsspezifikation

Englisch

Freigabe Agentur

Agentur-Freigabe-Blatt

Englisch